



TLC696x2/4/8-Q1 16 チャネル、2/4/8 時間多重化、車載用 ローカル調光バックライト LED ドライバ、

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - デバイス温度グレード 1: -40°C ~ +125°C、T_A
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応:
 - 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 動作電圧 V_{CC} 範囲: 3V ~ 5.5V
- 16 個の高精度定電流シンク:
 - 最大出力電流 / 電圧:
 - 30mA/20V: TLC69602/4/8-Q1
 - 60mA /20V: TLC69612/4/8-Q1
 - 30mA/50V: TLC69652/4/8-Q1
 - 60mA/50V: TLC69662/4/8-Q1
 - デバイス間誤差: ±2% (代表値)
 - チャンネル間誤差: ±2% (代表値)
- 柔軟な調光制御:
 - グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
 - 輝度分解能: 最大 15 ビット
 - PWM / ハイブリッド制御モード
- 高速デジタイズ・チェーン・インターフェイス:
 - I/O 電圧互換: 1.8V/3.3V
 - 最大 20MHz のデータ転送
- 高いシステム効率:
 - アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
 - 超低スタンバイ消費電力:
 - スタンバイ・モード: I_{CC} ≤ 200uA
 - 通常モード: I_{CC} ≤ 3.5mA
- EMI 強化:
 - プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
 - 4 つの位相シフト方式を内蔵
- 診断機能:
 - 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
 - デバイスのサーマル・シャットダウン検出
 - レポート・インターフェイス・オプション:
 - UART および割り込みピン (INT)
 - 2 線出力: CLK_O および SOUT

2 アプリケーション

- LCD ローカル調光バックライト:
 - 車載用集中情報ディスプレイ
 - 車載用クラスター・ディスプレイ
 - 車載用ヘッド・アップ・ディスプレイ

3 概要

TLC696x8-Q1 は、2/4/8 の時間多重化制御を実現する スキャン MOSFET コントローラである TLC696x0-Q1 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デジタイズ・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。

システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサクション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。

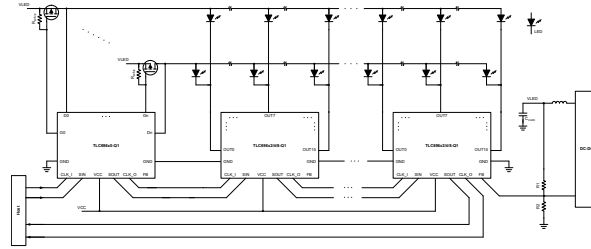
TLC696x2/4/8-Q1 には次の 3 つのエラー・フラグがあります。診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) です。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	本体サイズ (公称)
TLC696x2/4/8-Q1	WQFN (24) ウェットパブル・フラング	4mm × 4mm
	HTSSOP (28)	9.7mm × 4.4mm

(1) 利用可能なパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。





簡略回路図

Table of Contents

1 特長	1	5.2 サポート・リソース	4
2 アプリケーション	1	5.3 Trademarks	4
3 概要	1	5.4 静電気放電に関する注意事項	4
4 Revision History	3	5.5 用語集	4
5 Device and Documentation Support	4	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	5
5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	4		

4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

DATE	REVISION	NOTES
June 2023	*	Initial Release

5 Device and Documentation Support

TI offers an extensive line of development tools. Tools and software to evaluate the performance of the device, generate code, and develop solutions are listed below.

5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[ti.com](https://www.ti.com) のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.2 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

5.3 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLC69602QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69602Q
TLC69602QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69602Q
TLC69602QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69602Q
TLC69602QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69602Q
TLC69604QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69604Q
TLC69604QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69604Q
TLC69604QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69604Q
TLC69604QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69604Q
TLC69608QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69608Q
TLC69608QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69608Q
TLC69608QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69608Q
TLC69608QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69608Q
TLC69612QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69612Q
TLC69612QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69612Q
TLC69612QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69612Q
TLC69612QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69612Q
TLC69614QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69614Q
TLC69614QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69614Q
TLC69614QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69614Q
TLC69614QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69614Q
TLC69618QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69618Q
TLC69618QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69618Q
TLC69618QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69618Q
TLC69618QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69618Q
TLC69652QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69652Q
TLC69652QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69652Q
TLC69652QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69652Q
TLC69652QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69652Q
TLC69654QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69654Q

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLC69654QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69654Q
TLC69654QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69654Q
TLC69654QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69654Q
TLC69658QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69658Q
TLC69658QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69658Q
TLC69658QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69658Q
TLC69658QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69658Q
TLC69662QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69662Q
TLC69662QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69662Q
TLC69662QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69662Q
TLC69662QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69662Q
TLC69664QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69664Q
TLC69664QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69664Q
TLC69664QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69664Q
TLC69664QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69664Q
TLC69668QPWPRQ1	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69668Q
TLC69668QPWPRQ1.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 28	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	69668Q
TLC69668QRTWRQ1	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69668Q
TLC69668QRTWRQ1.A	Active	Production	WQFN (RTW) 24	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	69668Q

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

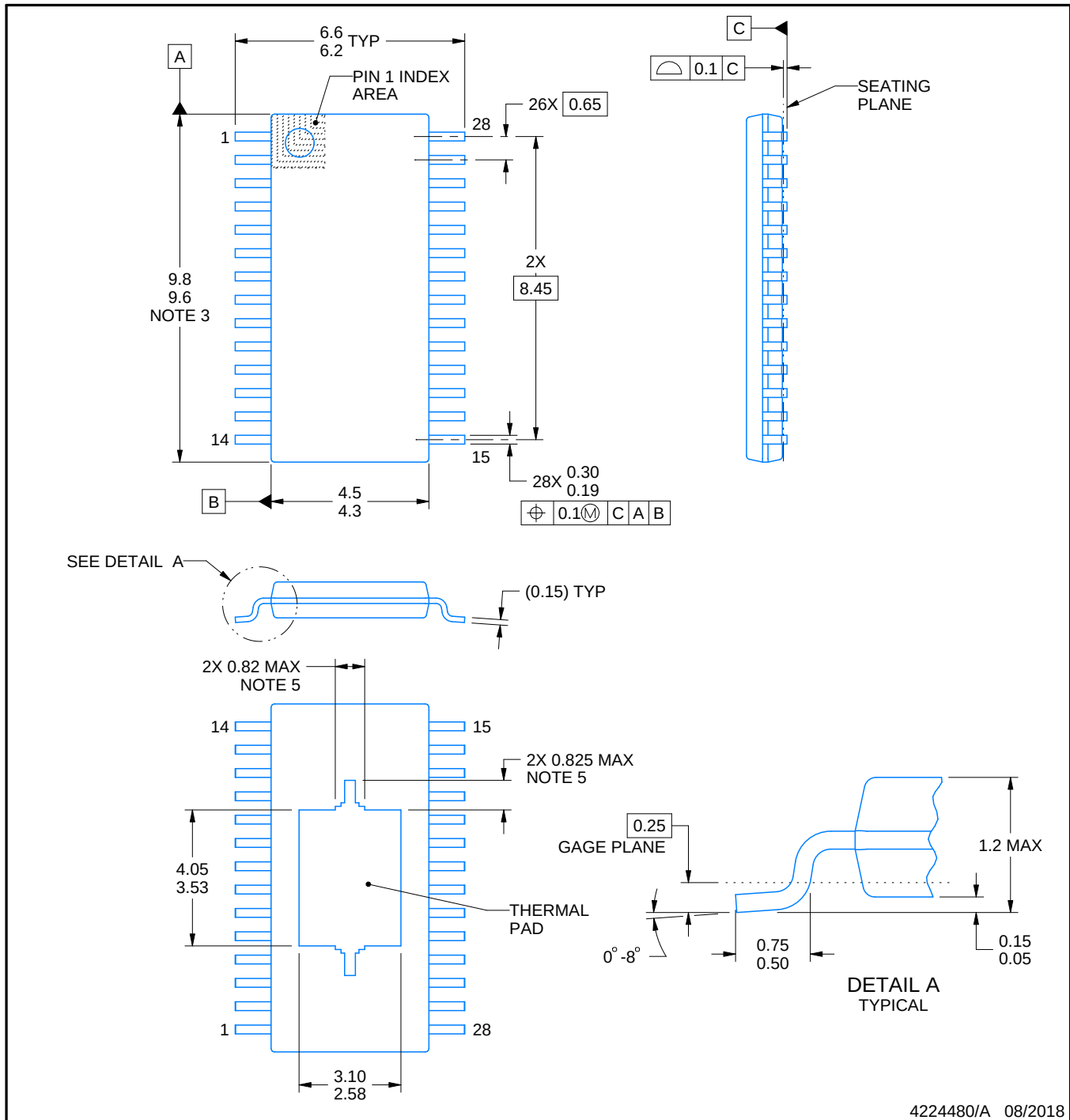
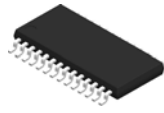
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLC69602-Q1, TLC69604-Q1, TLC69608-Q1, TLC69612-Q1, TLC69614-Q1, TLC69618-Q1, TLC69652-Q1, TLC69654-Q1, TLC69658-Q1, TLC69662-Q1, TLC69664-Q1, TLC69668-Q1 :

- Catalog : [TLC69602](#), [TLC69604](#), [TLC69608](#), [TLC69612](#), [TLC69614](#), [TLC69618](#), [TLC69652](#), [TLC69654](#), [TLC69658](#), [TLC69662](#), [TLC69664](#), [TLC69668](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product



4224480/A 08/2018

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

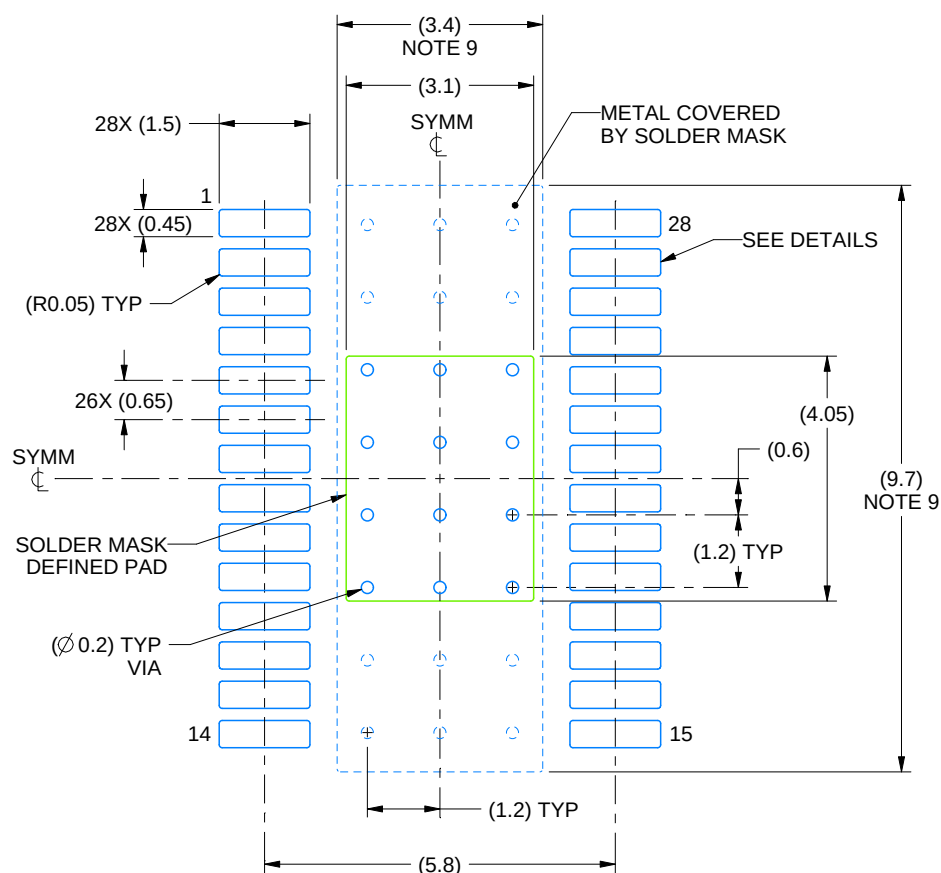
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-153.
5. Features may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

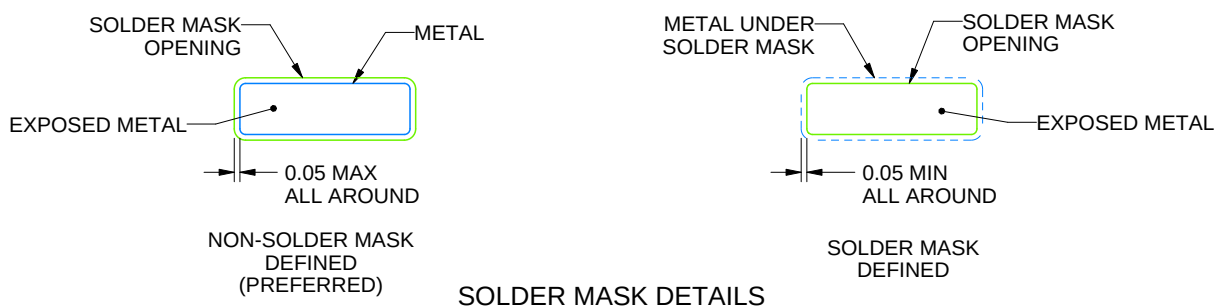
PWP0028M

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 8X



4224480/A 08/2018

NOTES: (continued)

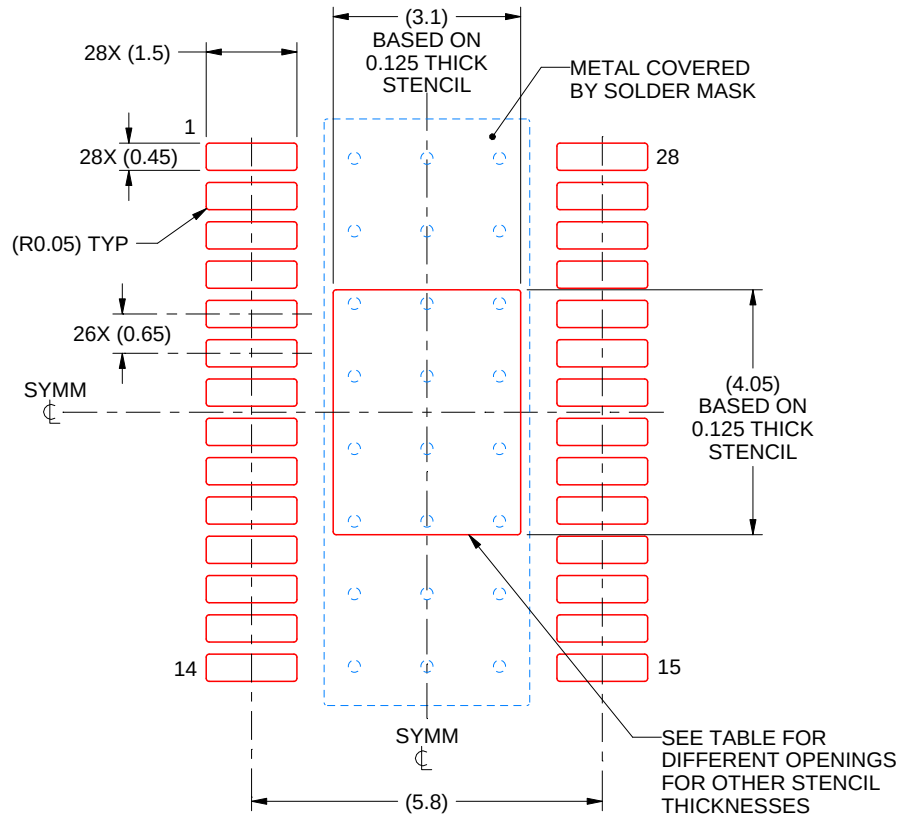
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PWP0028M

PowerPAD™ TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 8X

STENCIL THICKNESS	SOLDER STENCIL OPENING
0.1	3.47 X 4.53
0.125	3.10 X 4.05 (SHOWN)
0.15	2.83 X 3.70
0.175	2.62 X 3.42

4224480/A 08/2018

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

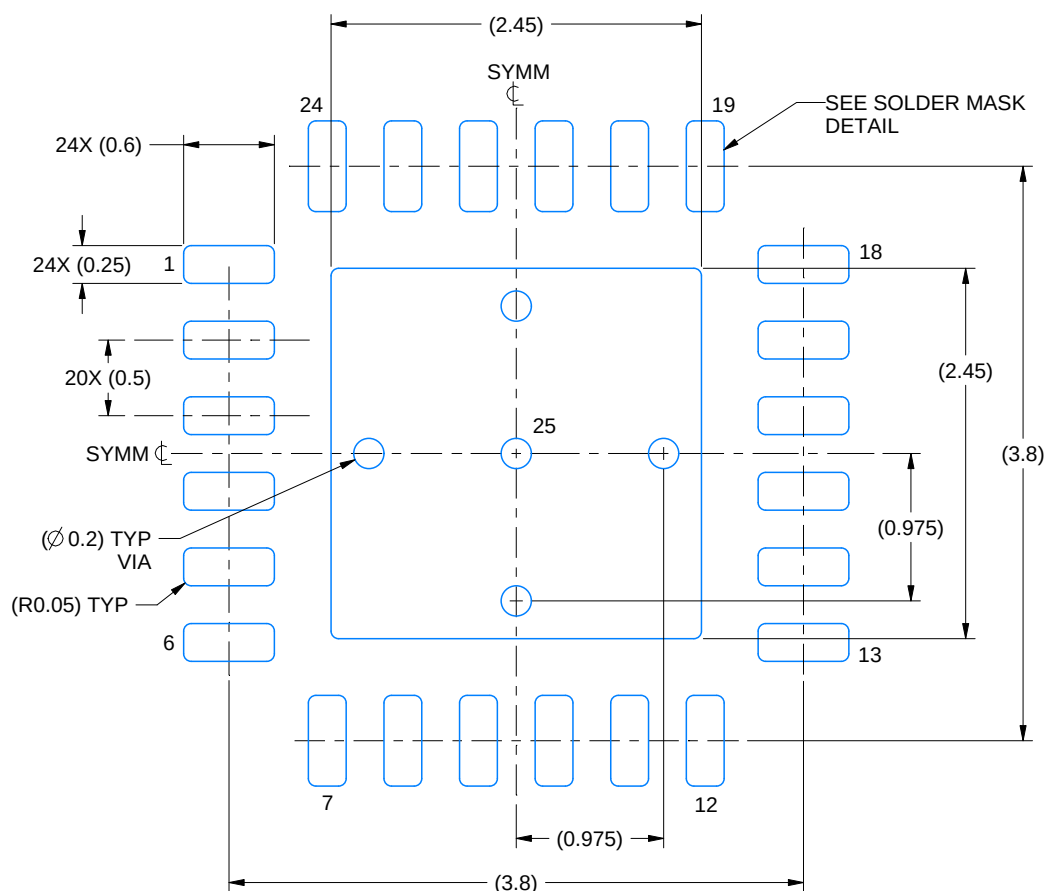


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
4. Reference JEDEC registration MO-220. For wettable flank, reference IPC document IPC-7093.

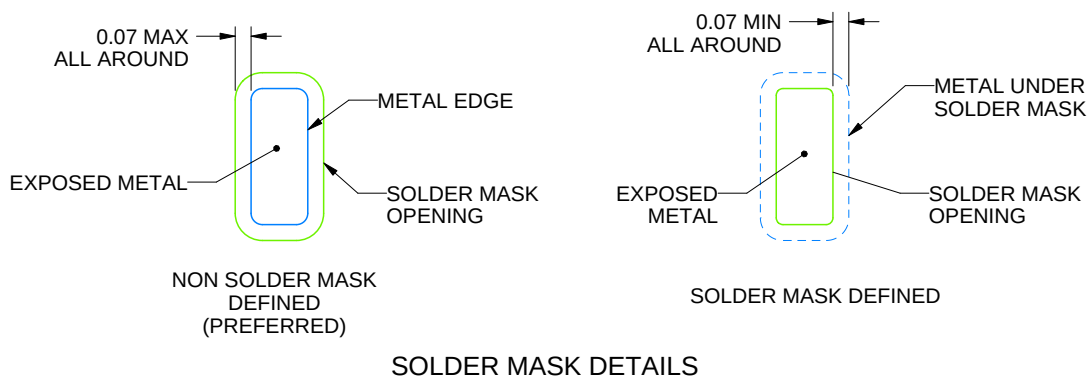
RTW0024N

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4229295/B 07/2023

NOTES: (continued)

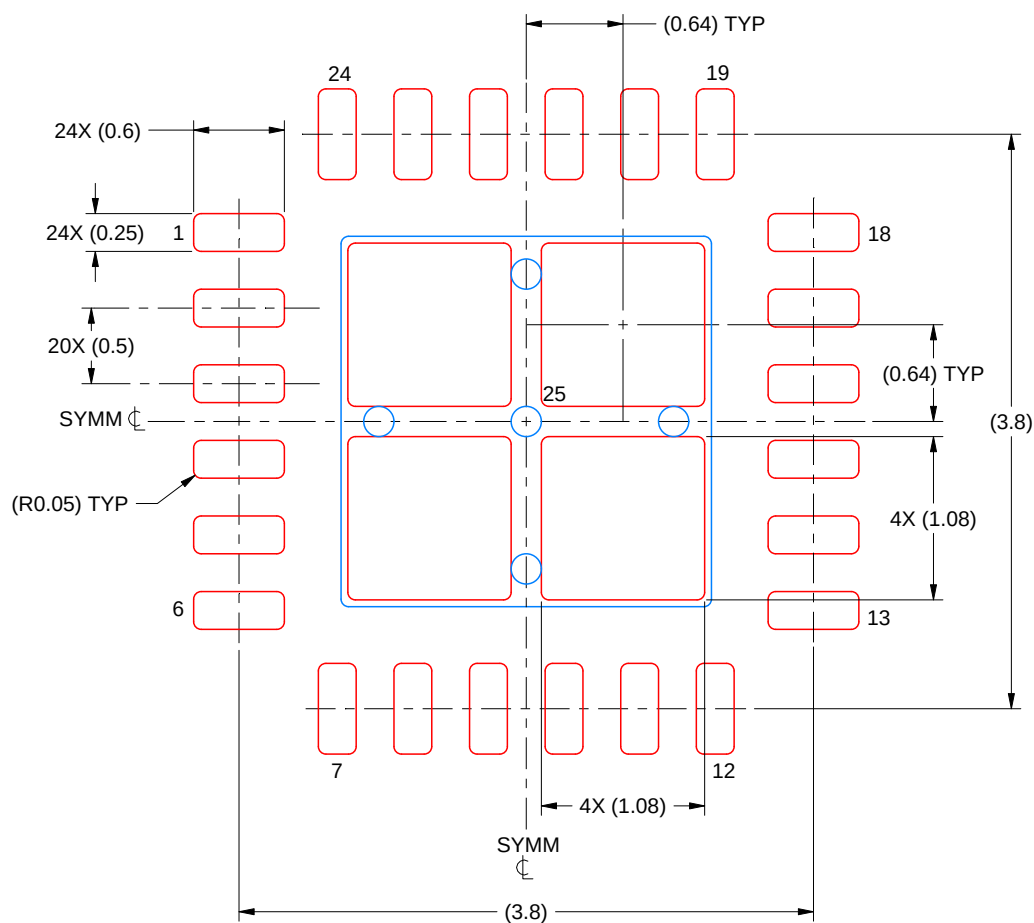
5. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RTW0024N

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X

EXPOSED PAD 25
78% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4229295/B 07/2023

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月